

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年12月24日(24.12.2020)



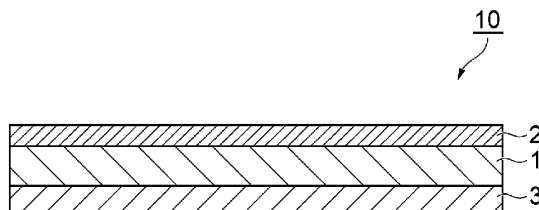
(10) 国際公開番号

WO 2020/255975 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/29 (2006.01) H01L 23/50 (2006.01)
H01L 23/31 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/023647
- (22) 国際出願日: 2020年6月16日(16.06.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-113464 2019年6月19日(19.06.2019) JP
- (71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 名児耶 友宏 (NAGOYA Tomohiro);
〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: TEMPORARY PROTECTIVE FILM FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION MOLDING, LEAD FRAME WITH TEMPORARY PROTECTIVE FILM, ENCAPSULATION MOLDED BODY WITH TEMPORARY PROTECTIVE FILM, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体封止成形用仮保護フィルム、仮保護フィルム付きリードフレーム、仮保護フィルム付き封止成形体、及び半導体装置を製造する方法



(57) Abstract: Provided is a temporary protective film for semiconductor encapsulation molding which includes a support film, an adhesive layer that is formed on one surface of the support film, and a non-adhesive layer that is formed on the surface of the support film opposite the surface on which the adhesive layer is formed. The non-adhesive layer has a thickness of 10 μm or less. The surface of the non-adhesive layer opposite the surface that contacts the support film has a surface roughness Ra of 0.1 μm or more.

(57) 要約: 支持フィルムと、支持フィルムの一方向の面上に設けられた接着層と、支持フィルムの接着層が設けられた面とは反対側の面上に設けられた非接着層と、を備える半導体封止成形用仮保護フィルムが開示される。非接着層の厚さが 10 μm 以下である。非接着層の支持フィルムと接する面とは反対側の面の表面粗さ Ra が、0.1 μm 以上である。

[続葉有]



WO 2020/255975 A1

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))